

2023年度 第 2 回 ARIM量子・電子マテリアル領域セミナー 電子ビーム露光技術 ~ 進化する電子ビーム露光装置 ~

共用装置としてのELSとJBX

- NIMSにおける運用体制 -

P

NIMS微細加工ユニット 大里 啓孝



アジェンダ



- ➤ NIMSのEB描画装置運用体制 装置・描画ファイル生成環境・レジストラインナップ
- ▶ 評価パターンの描画 フィールド繋ぎ / L&Sパターンの評価
- TopicsScriptによるファイル生成





NIMSの最新鋭EB描画装置運用体制

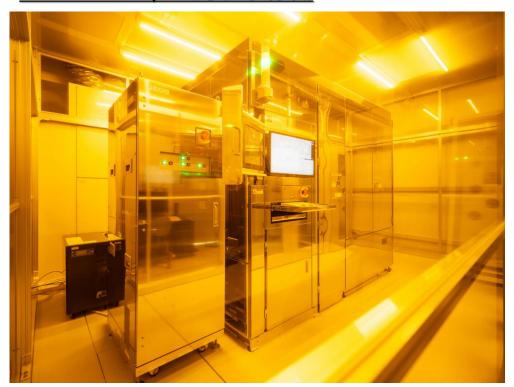
- 装置・描画ファイル生成環境・レジストラインナップ-





日本電子: JBX-8100FS

NEW! 2023/12月より稼働



千現地区 : 描画室(クリーンブース)		
加速電圧	200kV	
電流	50pA – 50nA	
フィールドサイズ	500um	
最小ドットピッチ	0.25nm	
最小ショットタイム	8nsec/dot(125MHz)	
フィールドつなぎ精度	20nm以下	
重ね合わせ精度	20nm以下	
最大試料サイズ	小片~8inchφ	
画像検出器	SE / BSE	
対応CADフォーマット	DXF / GDS	
その他	12カセット オートローダー	





エリオニクス: ELS-BODEN100

2022/4月より稼働



並木地区:クリーンルーム		
加速電圧	100kV	
電流	100pA – 20nA	
フィールドサイズ	100 / 250 / 500 / 1000um	
最小ドットピッチ	0.2nm	
最小ショットタイム	10nsec/dot(100MHz)	
フィールドつなぎ精度	30nm以下	
重ね合わせ精度	30nm以下	
最大試料サイズ	小片~8inchφ	
画像検出器	SE / BSE	
対応CADフォーマット	DXF / GDS	
その他	シングルカセット オートローダー	



描画ファイル生成環境



GenISysソフトウェアライセンス

◆ BEAMER × 3 (CPU : 12Core)

JEOL Format × 1

Elionix Format \times 2

HIMT Format × 2 (レーザー露光用)

lack TRACER \times 2

描画装置3台のファイル生成環境

◆ Work Station 4 台をネットワーク接続

Core i9 13900K × 2 (ELS-BODEN100用)

Core i9 14900K × 1 (ELS-F125用)

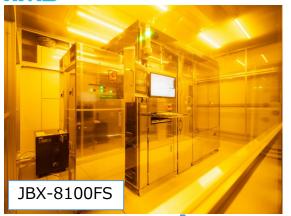
Xeon W2455X × 1 (JBX-8100FS用)

◆ 1台をライセンスサーバー兼ファイルサーバー





描画装置周りのネットワーク環境







ダウンロード

GenlSysライセンス





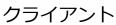


ライセンスサーバー















利用可能レジスト

Resist(Thickness)	Туре	Resolution
FEP-171D(200 / 400 / 800nm)	Positive : CAR	100nmL&S \sim
AR-P6200(50 / 100 / 200 / 400nm)	Positive	50nmL&S \sim
PMMA(100 / 500nm)	Positive	50nmL&S \sim
NEB22A2(200nm)	Negative : CAR	100nmL&S \sim
H-SiOx(50nm)	Negative	30nmL&S \sim

- ◆ 保有レジストは各装置で標準条件完備
- ◆ 新規レジストも積極的に導入
- ◆ レジストの持ち込み可
- ◆ レジスト開発の受け入れ実績あり





評価パターンの描画

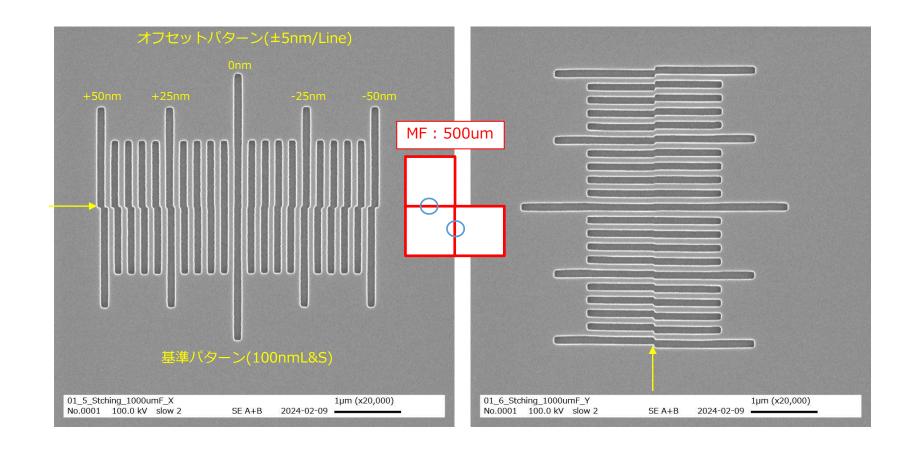
- フィールド繋ぎ / L&Sパターンの評価 -

設置環境等の影響もございますのであくまで参考として





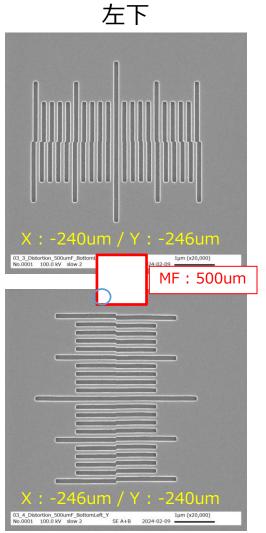
メインフィールド繋ぎ合わせ: JBX-8100FS

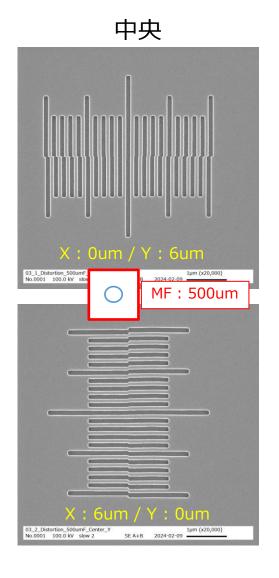


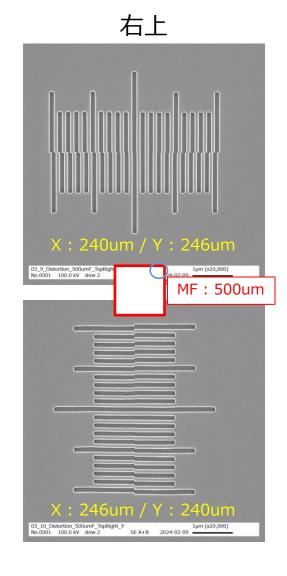




サブフィールド繋ぎ合わせ: JBX-8100FS







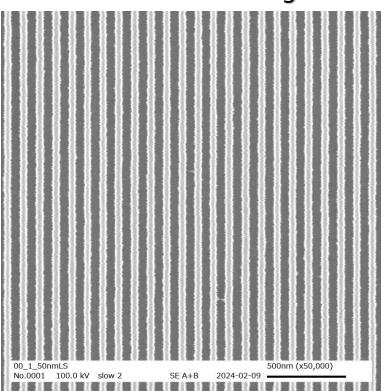




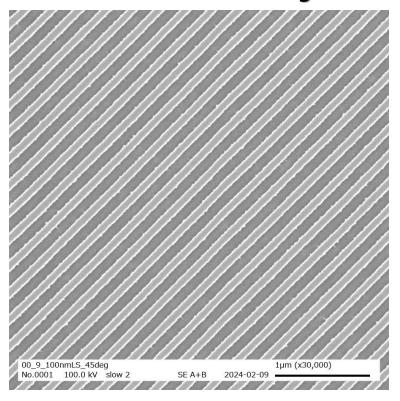
L&Sパターン: JBX-8100FS

Resist	Current	Shot Pitch	Area Dose
AR-P6200 / 100nm	5nA	10nm	460uC/cm2

50nmL&S: 90deg



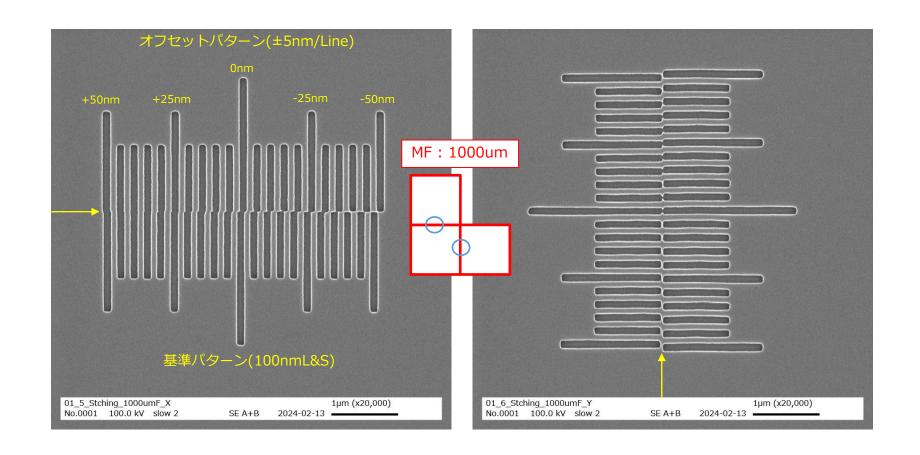
100nmL&S: 45deg







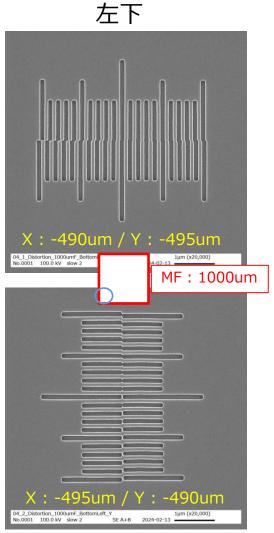
メインフィールド繋ぎ合わせ: ELS-BODEN100

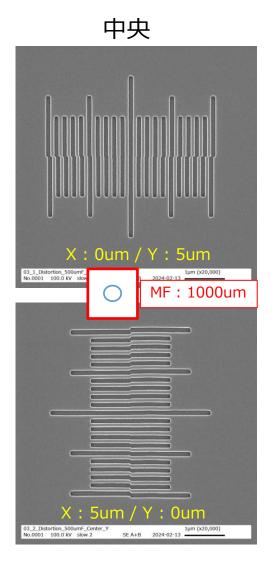


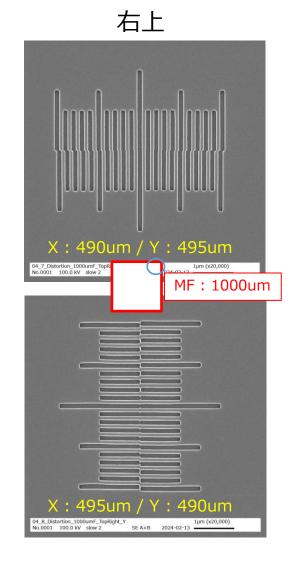




サブフィールド繋ぎ合わせ: ELS-BODEN100







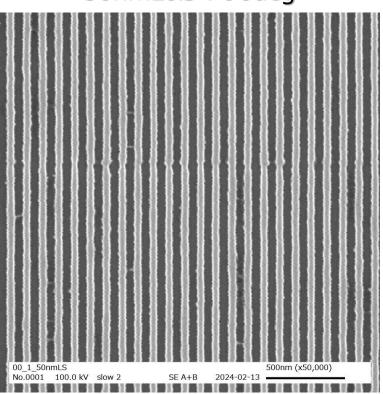




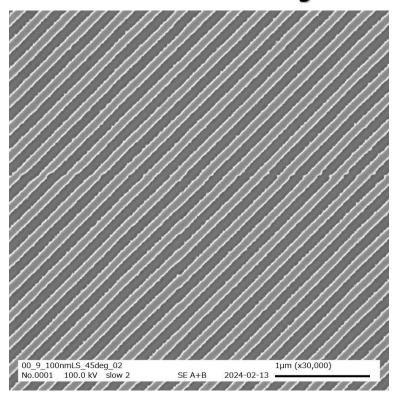
L&Sパターン: ELS-BODEN100

Resist	Current	Shot Pitch	Area Dose
AR-P6200 / 100nm	5nA	10nm	280uC/cm2

50nmL&S: 90deg



100nmL&S: 45deg

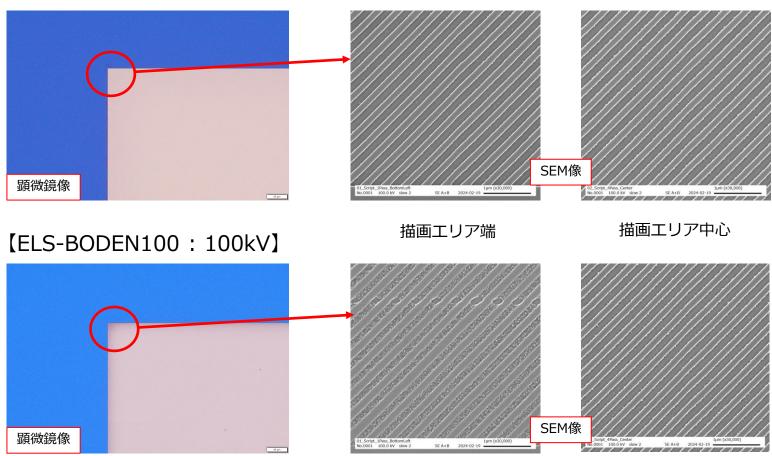






100kV / 200kVの近接効果

[JBX-8100FS: 200kV]



200kVでは補正無しでもアレイパターンの端が解像している とはいえ、粗密混合パターンでは近接効果補正が必要





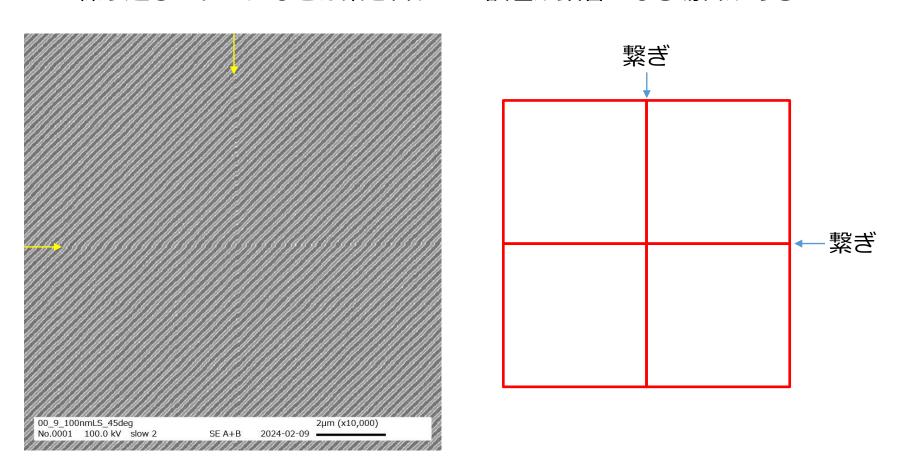
Topics: Scriptによるファイル生成





フィールドの繋ぎ合わせ

繰り返しパターンなどは繋ぎ合わせの誤差が顕著になる場合がある



BEAMERでオーバーラップ処理は可能だが設計をScriptで自作する方法もある





ScriptによるGDS生成

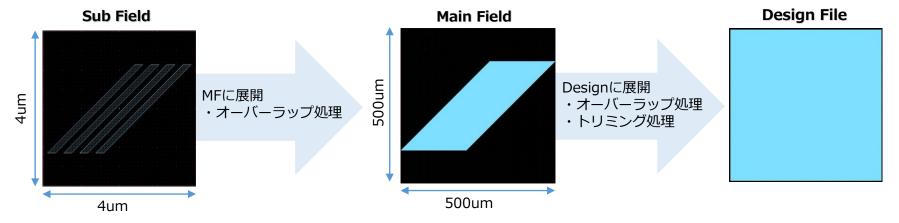
例)Python Script

◆ GDSファイルをScriptから生成する意義

手作業の設計より圧倒的に高速アルゴリズムを実装すれば様々なことが自動化可能

- ⇒ メイン・サブフィールドのオーバーラップ
- ⇒ GDS内に特定の配列を埋め込むことが可能 ・・・メイン・サブフィールドの描画動作を規定

◆ <u>生成アルゴリズム(JBX-8100FS)</u> *計算方法を変えればELS-BODEN100でも使用可



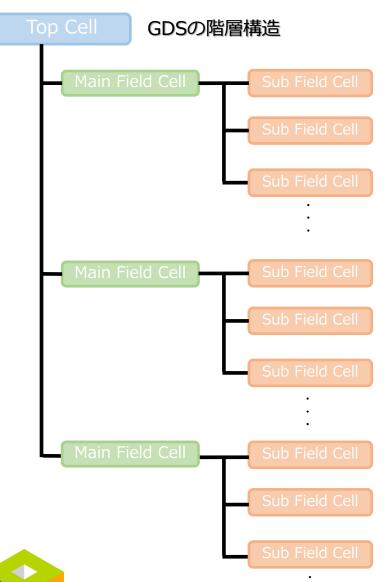


仕上がり・スピードの向上において有用になる場合がある

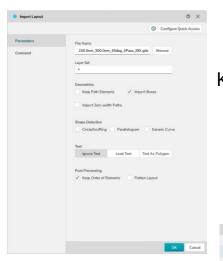




階層構造の維持



BEAMERの変換設定



【Import】
Keep Order of Elements

【Export】
Cell To Position Set



階層構造を維持したままバイナリーファイル生成

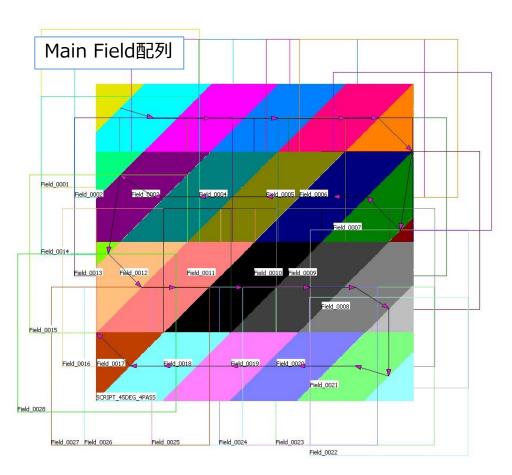




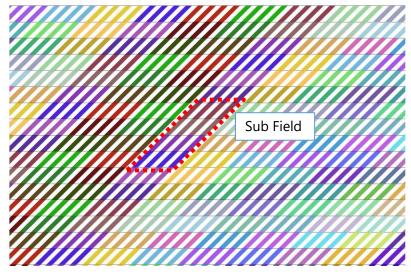




設計サイズ:1mm□/4Pass処理



Sub Field配列



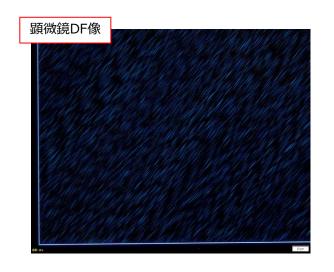




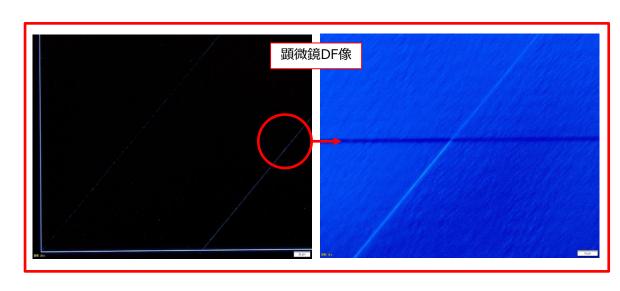
描画条件と仕上がり

【描画条件】

EB Writer	Resist	Current	Shot Pitch	Area Dose
JBX-8100FS	AR-P6200 / 100nm	5nA	10nm	460uC/cm2



描画パターンが不均一な例



描画パターンが均一

⇒Main Fieldの繋ぎ・Pitch移動の部分にズレや歪みが見える

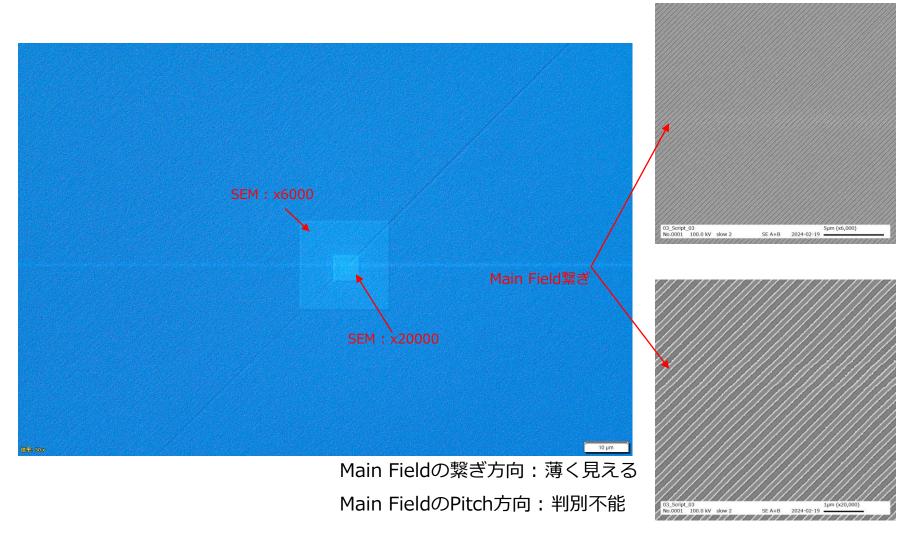


上手くカバーしているつもりでも全面均一化はなかなか難しい





繋ぎ部分のSEM画像





より良い結果を得るためにはデータの生成方法も重要です



設計に応じた機種の選定が重要

• JBX-8100FS

- ◆ 理解して使えばピーク性能がとても高い
- ◆ 繋ぎ合わせ性能が非常に良い
- ◆ 絶対的な精度が必要ならこちら

ELS-BODEN100

- ◆ 描画性能・速度のバランスが安定している
- ◆ ソフトウェアのデザインが初心者でも理解しやすい
- ◆ 気軽にEB描画装置を使うならこちら

NIMSでは用途に応じて

最適な機種

をご提案いたします

不本意な結果について

装置設置環境の温度コントロールに

設置環境が5階

改善の余地あり

メーカー様 ご協力お願いします!







以上のように、NIMSでは最新鋭の描画装置をより良い環境で 利用できるように運営しております

スタッフ一同、皆様のご利用をお待ちしております

